

## RH-TSG-102 导热硅脂

### 特色:

- 有机硅导热复合物
- 耐高温, 无小分子释放
- 非固化型

### 产品特点

- 导热系数: 0.9W/m·K
- 无溶剂配方
- 较低粘度, 易进行快速大面积丝网涂刷
- 施胶后无残余应力, 有效保护精密电子元器件不受损伤

### 产品应用

- CPU、IGBT 等半导体散热
- 汽车电子设备
- LED 照明
- 大型存储设备
- 智能手机模块及消费电子

### 常见性能参数\*

参考标准	项目	单位	数值
常规特性 (25 ± 2°C, 60 ± 5%RH)			
—	组分	—	单组分
—	颜色	—	白色
ASTM D2196	粘度	mPa.s	50000
ASTM D792	密度	g/cm <sup>3</sup>	2.68
ASTM D5470	热阻@ 40psi	°C .cm <sup>2</sup> /W	0.65
ASTM D5470	导热系数	W/m·K	0.9±0.1
—	操作温度	°C	-40 ~ 125

### 使用说明

- 产品放置时间长后建议预先搅拌, 然后再使用。
- 当需要应用于材料上时, 使用前请小样确认, 然后再应用。
- 使用前清洗待涂覆表面, 除去污渍。
- 注意施工表面应该均匀一致, 只要涂覆薄薄一层即可。
- 产品不宜长期暴露在空气中。

### 运输储存条件

- 在 8-28°C 阴凉干燥处贮存, 最佳使用期限为 6 个月以内

### 其他注意事项

- 远离儿童存放
- 避免人体皮肤直接接触, 若不慎接触皮肤, 擦拭干净, 然后用清水冲洗
- 若不慎接触眼睛, 立即用清水冲洗并到医院检查

- 产品的使用不是涂的越多越好，而是在保证填满间隙的前提下越薄越好
- 使用表面需保持清洁